

公司代码：688403

公司简称：汇成股份

转债代码：118049

转债简称：汇成转债

合肥新汇成微电子股份有限公司
2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

2、 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“四、风险因素”相关内容。请投资者注意投资风险。

3、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、 公司全体董事出席董事会会议。

5、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

7、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2025年度利润分配预案为：拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2025年3月18日，公司总股本897,840,630股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利44,892,031.50元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为29.01%。

如在年度报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/可转债转股/股权激励授予/股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额。如后续总股本发生变化，公司将在权益分派实施前另行公告具体调整情况。

公司2025年度利润分派预案已经公司第二届董事会第十七次会议审议，尚需提交公司2025年年度股东会审议，实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。

母公司存在未弥补亏损

适用 不适用

8、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	汇成股份	688403	不适用

1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	奚颢	王赞
联系地址	安徽省合肥市新站高新技术产业开发区合肥综合保税区内项王路8号	安徽省合肥市新站高新技术产业开发区合肥综合保税区内项王路8号
电话	0551-67139968-7099	0551-67139968-7099
传真	0551-67139968-7099	0551-67139968-7099
电子信箱	zhengquan@unionsemicon.com.cn	zhengquan@unionsemicon.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

公司主营集成电路先进封装测试服务，所封测的芯片类型目前聚焦在液晶面板核心部件之一显示驱动芯片，并持续布局存储芯片封测领域。公司直接客户主要为显示驱动芯片设计企业，客户自购晶圆委托公司为其提供凸块制造（Bumping）、晶圆测试（CP）、玻璃覆晶封装（COG）和薄膜覆晶封装（COF）加工服务，加工完成后的显示驱动芯片由客户销售给下游，主要应用于 LCD、OLED 显示面板，并应用于消费电子、工业控制、车载电子等终端应用场景。

报告期内，公司主要提供显示驱动芯片全制程封装测试统包服务。在封测业务制程方面，公司主营业务收入一般按照凸块制造（Bumping）、晶圆测试（CP）、玻璃覆晶封装（COG）和薄膜覆晶封装（COF）四大制程进行划分；按照所封测芯片的细分类型，主要分为 LCD 面板显示驱动芯片（DDI）、触控与显示驱动集成芯片（TDDI）、AMOLED 面板显示驱动芯片等；按照终端应用场景，主要分为智能手机、高清电视、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴、汽车电子、电子标签等类别。公司显示驱动芯片封装测试制程服务具体情况如下：

工艺制程	具体介绍	功能特点	应用范围或领域
Bumping	凸块制造是指通过溅镀、曝光显影、电镀和蚀刻等制程，在晶圆的焊垫上制作凸块，可达到高效的电性传输，替代了传统封装中的导线键合。公司凸块制造工艺可实现凸块宽度与间距最小至 6 μ m、单片 12 吋晶圆上制造约千万颗凸块	该工艺可大幅缩小芯片模组的体积，具有密度大、散热佳、高可靠性等优点	主要应用于显示驱动芯片领域，适用于覆晶封装（FC）技术
CP	晶圆测试是指用探针与晶圆上的每个晶粒接触进行电气连接以检测其电气特性，对于检测不合格的晶粒用点墨进行标识，在切割环节被淘汰，不再进行下一个制程	该工艺不仅可以鉴别出合格的芯片，直接计算出良率，还可以减少后续不必要的操作，有效降低整体封装的成本	是大多数封装工艺必经的前道工序
COG	玻璃覆晶封装是指将芯片上的金凸块与玻璃基板上的引脚进行接合并利用胶质材料进行密封隔绝的技术，由封装厂商负责切割成型，面板或模组厂商等负责芯片与面板的接合	是目前较为传统的屏幕封装工艺，也是最具有性价比的解决方案，但由于芯片直接放置在玻璃基板上，占用较大空间，故屏占比不高	主要应用于小尺寸面板，如手机、平板电脑、数码相机等
COF	薄膜覆晶封装是指将芯片的凸块与卷带上的内引脚接合，之后由面板或模组厂商等将外引脚与玻璃基板接合	具有高密度、高可靠性、轻薄短小、可弯曲等优点，有利于缩小屏幕边框，提高屏占比	主要应用于电视等大尺寸面板和全面屏手机等

2.2 主要经营模式

1、盈利模式

公司属于集成电路行业的封装测试服务环节企业，采用行业惯用的 OSAT（半导体封装测试外包）模式，在 OSAT 模式下，公司业务不涉及集成电路设计环节和晶圆制造环节，专门为集成电路设计公司提供封装测试服务。公司根据客户需求，通过工艺设计，利用封装测试设备，自行购买封装测试原辅料，对客户提供的晶圆进行凸块制造、晶圆测试、研磨、切割、封装等一系列的定制化精密加工及成品测试服务。公司通过为客户提供服务并收取加工服务费的方式获取收入和利润。

2、采购模式

公司的采购模式为按需采购，由物料采购部门统计生产有关的物料耗材需求并编制需求单，根据需求单向供应商下达采购订单并签约。对于主要采购材料，公司一般会与供应商约定年度协议价格，未约定年度协议价格的则进行比价选定。采购材料根据合同要求付款，由采购部门根据

合同约定制作付款申请单、经系统签核后，到期支付款项。采购材料到货后由相关部门进行验收，品质部门核对供应商提供的出货检测报告后进行分类抽检，检验合格后在系统中制作验收单，经系统签核后确认收货。

公司建立了供应商认证准入机制和考核机制，以保证供应质量及供应稳定性。公司仅向评估合格的供应商进行采购，评估内容包括供应商资质、材料质量、采购效益等，并且在采购的过程中持续考核其产品质量及服务等方面，对质量问题实时反馈并要求修正。

3、生产模式

公司目前采用行业普遍的“客户定制，以销定产”受托加工生产模式，即由客户提出需求并提供晶圆、卷带等制造材料，公司自行外购电镀液、金属靶材等封装测试原辅料，接着根据客户需求完成相应工艺制程，而后将成品交付给客户或指定面板厂商等第三方。

公司专注于提供高端封装和测试服务，拥有专业的工程技术和生产管理团队，并配备了专业的高精度自动化生产设备，可以提供多样化、针对性、差异化及个性化的封装测试服务。

4、销售模式

公司采用直销模式进行销售，并制定了相应的销售管理制度。

作为集成电路封装测试企业，公司需要对客户的技术需求进行工艺验证，验证通过后方可与客户开始合作。公司在获取客户具体订单后完成封装测试服务，并依据客户的具体要求将封装完成的芯片交付。公司依据与客户的具体约定进行销售结算及收款。

基于定制化的受托加工模式，公司的销售定价主要由自行采购的材料成本以及根据客户对工艺的要求协商达成的加工服务费共同构成。由于每个客户的芯片封装测试方案都具有定制化、个性化的特点，整体定价在衡量客户订单规模、公司产能综合利用情况并结合市场供需行情等因素下，与客户协商确定。后续亦会根据客户的特定工艺要求等做相应调整。

凸块制造的定价基于耗用的原材料成本及相应的加工服务费确定。晶圆测试、玻璃覆晶封装与薄膜覆晶封装主要基于不同芯片的具体工艺要求，综合考虑加工设备类型、加工时长及市场供需行情的因素下，与客户协商确定。

5、研发模式

公司主要通过自主研发的模式持续对先进封装测试工艺进行研发活动，夯实已有技术基础的同时进一步提高技术壁垒，并保障研发项目成功投产转化。公司主要基于客户产品或技术方案的最新趋势，进行相应的研发投入。公司制定的研发流程主要包括项目调研、项目立项、工艺设计与开发、样品试制和研发结项等阶段，具体情况如下：

（1）项目调研

公司的研发项目主要来源于以下渠道：一是研发中心会定期调研行业发展趋势，结合公司发展战略及现有技术基础，选择相应的新技术、新工艺的研发立项；二是业务营销部在市场开拓过程中会有意收集客户需求信息，形成对市场需求的综合判断，针对市场需求集中的新产品提出立项建议。

（2）项目立项

研发中心在项目调研或收到立项建议后，将先进行初步论证，如初步论证可行，则会同公司管理层共同讨论立项建议，根据开发产品、工艺的技术指标、技术难点、成本效益等内容进行评判，确定具体研发内容，进而对资源配置、执行周期、项目人员等进行部署，形成研发项目立项书后正式启动项目研发工作。

（3）工艺设计与开发

公司根据项目立项书及技术可行性分析的要求，开展设计开发工作。由研发中心设立专项课题小组，积极调动各种资源以配合专项课题小组的活动。工艺设计开发完成后，将召开评审会议，对项目取得的研发成果予以评定。专项课题小组根据会议评审结果，对项目设计与开发方案予以进一步修改、完善，并及时反馈给研发中心相关负责人。

（4）样品试制

专项课题小组会同生产制造部根据评审会议确定的技术参数和开发方案进行样品试制，专项课题小组辅以监督和技术指导，试制完成的样品由品质保障部进行质量及性能的检验。若该研发样品是根据客户需求开发的，则样品还需经过客户验证。

（5）研发结项

在验证合格后，研发中心将召开项目评审会，对样品的性能参数予以全面评估。评审会通过后专项课题小组提交研发结项报告，项目研发工作结束。

2.3 所处行业情况

1、行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

（1）所处行业

公司主营业务为集成电路的封装测试，根据《国民经济行业分类》（GB/4754-2017），公司属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”之“C3973 集成电路制造业”；根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司属于“1 新一代信息技术产业”之“1.2 电子核心产业”之“1.2.4 集成电路制造业”，是电子核心产业中兼具技术密集与资金密集属性的关键环节。

（2）行业发展阶段及基本特点

自上世纪 50 年代集成电路诞生以来，集成电路封装测试行业随着集成电路设计和制造技术的发展而演进，已历经了 60 余年的发展过程，大致可以划分为五个发展阶段：20 世纪 70 年代以前属于集成电路封装技术发展的第一阶段，以通孔插装型封装为主；20 世纪 80 年代以后开始进入第二阶段，以表面贴装型封装为主；20 世纪 90 年代以后，以芯片级封装(CSP)、晶圆级封装(WLP)、球栅阵列封装(BGA)为代表的面积阵列型封装技术逐渐成熟，进入封装技术发展的第三阶段；20 世纪末开始，凸块制造(Bumping)、系统级封装(SiP)等技术推动集成电路封装进入第四阶段；进入 21 世纪之后，倒装封装(FC)、晶圆级系统封装-硅通孔(TSV)、系统级单芯片封装(SoC)、扇外型封装(Fan-out)等形式的集成电路封装层出不穷，封装技术发展进入第五阶段。基于国家发改委发布的《产业结构调整指导目录》，并结合行业内按照封装工艺分类的惯例，封装分为传统封装（第一阶段和第二阶段）及先进封装（第三至第五阶段）。

先进封装是现代集成电路制造技术的关键环节，即采用先进的设计思路和先进的集成工艺对芯片进行封装级重构，并能够有效提高功能密度的封装方式。在业内，先进封装和传统封装主要以是否采用引线焊接来区分，传统封装通常采用引线键合的方式实现电气连接，先进封装通常采用凸块(Bump)等键合方式实现电气连接。从封装效果来看，传统封装更加关注物理连接层面的优化，本身对芯片的功能不会产生实质变化，主要起到保护、嵌套、连接的作用；先进封装更加关注电路系统层面的优化，除常规的保护、嵌套、连接外，还可起到缩短互联长度、提高互联性能、提升功能密度、实现系统重构等作用。

近年来，智能手机等移动终端向小型化、集成化、高性能方向更新迭代，带动单机芯片数量和芯片性能要求的提升，是全球先进封装行业发展的最重要驱动因素之一。未来，全球先进封装行业的主要增长点将由智能手机等移动终端向人工智能、数据中心、云计算、自动驾驶等高性能运算转变。在后摩尔定律时代，以凸块制造(Bumping)、重布线(RDL)、硅通孔(TSV)、混合键合(Hybrid bonding)、三维芯片集成(2.5D/3D)、扇外型封装(FOWLP)等为代表的先进封装工艺正逐步发展为推动芯片效能提升的主流发展方向，先进封装在整体封装产业当中的占比正稳步提升。

（3）主要技术门槛

集成电路高端先进封装测试属于高新技术产业，先进封装测试服务的专业性、复杂性、系统性特征，决定了企业进入该行业需突破较高的技术壁垒。芯片封装测试对设备、工艺以及生产稳定性有着严苛的要求，客户验证和导入的周期较长。

显示驱动芯片封装测试的技术壁垒主要体现在凸块制造环节工艺复杂性、全流程良率稳定性两个方面。

凸块制造环节具有溅镀、黄光（光刻）、蚀刻、电镀等多道环节，需要在单片晶圆表面制作数百万个极其微小的凸块作为芯片封装的引脚，对凸块制造的精度、可靠性、微细间距均具有较高要求，因而目前中国大陆具备较高良率水平及稳定量产凸块制造能力的封测企业相对较少。

显示驱动芯片领域对于封装测试有着较高的良率要求。显示驱动芯片应用于各类电子产品液晶面板，单块液晶面板的价值较高，特别是应用于高清电视等终端的大尺寸面板。如果在封装测试环节不合格品流向终端客户，封测企业将面临较大金额的质量赔付，并且还存在声誉损失甚至客户流失的风险。正是因为客户以及终端对良率的高要求，倒逼显示驱动芯片封测企业需要投入大量技术资源和管理资源用于提高良率，保证生产稳定性，行业新进入者面临着较高的良率稳定性壁垒。

2、公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是中国境内最早具备金凸块制造能力的封测厂商之一，拥有 8 吋及 12 吋晶圆全制程封装测试技术和产能。近年来，随着公司 IPO 及可转债募投项目快速实施，公司在产能规模、实际产出、市场份额等方面均实现了跨越式发展，技术水平、产品良率及客户认可度亦稳步提升，在全球显示驱动芯片封测领域已跻身第一梯队，具备领先优势。

公司在显示驱动芯片封装测试领域深耕多年，凭借先进的封测技术、稳定的产品良率与优质的服务能力，积累了丰富的客户资源。公司客户包括联咏科技、天钰科技、瑞鼎科技、奇景光电、矽创电子、三星 LSI、集创北方、奕力科技、云英谷、新相微等全球知名显示驱动芯片设计企业。

3、报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

目前，全球已步入以算力为核心生产力的全面数字经济时代，数字经济正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。数字经济的快速发展不仅带动集成电路市场需求激增，更对其性能提出更高要求。

由于摩尔定律逐步逼近极限，单纯依靠制程节点推进已无法有效优化芯片性能与功耗，且面临成本、良率等多重挑战。先进封装技术凭借提升封装集成度，实现了芯片性能与功耗的实质性突破，正逐步成为封测行业发展主流。在 AI、HPC、高速通信等终端应用领域迅猛发展的驱动下，以 TSV、Fan-Out、WLCSP 为代表的先进封装技术市场需求迎来爆发性增长。与此同时，HBM、Chiplet 等前沿领域的发展，进一步推动先进封装技术迭代与产业应用向纵深演进。

此外，先进封装技术要求芯片前期设计融合晶圆制造与封装测试技术，倒逼封测企业与上下游环节建立更加紧密的跨环节沟通机制。产业链协同能力，正成为衡量封测企业核心竞争力的关键考量。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年 增减(%)	2023年
总资产	4,874,601,292.34	4,591,223,702.62	6.17	3,596,296,963.42
归属于上市公司股东的净资产	3,548,994,652.26	3,201,070,920.63	10.87	3,132,030,678.41
营业收入	1,783,135,467.97	1,501,019,718.15	18.79	1,238,293,041.85
利润总额	159,014,574.99	153,350,052.42	3.69	195,582,886.58
归属于上市公司股东的净利润	154,730,588.81	159,764,193.29	-3.15	195,985,017.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	124,099,626.09	134,003,912.85	-7.39	168,194,709.94
经营活动产生的现金流量净额	692,458,788.26	500,863,803.23	38.25	351,459,642.36
加权平均净资产收益率(%)	4.68	5.12	下降0.44个百分点	6.49
基本每股收益(元/股)	0.19	0.19	-	0.23
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.19	-5.26	0.23
研发投入占营业收入的比例(%)	6.60	5.96	上升0.64个百分点	6.37

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	374,578,911.73	491,614,195.51	429,164,325.87	487,778,034.86
归属于上市公司股东的净利润	40,588,834.35	55,450,975.13	28,205,059.00	30,485,720.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	34,181,714.67	48,637,711.63	19,260,895.34	22,019,304.45
经营活动产生的现金流量净额	150,299,217.76	236,229,633.78	90,094,560.56	215,835,376.16

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4、股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	21,521						
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	28,513						
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用						
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用						
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用						
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用						
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份 数 量	质押、标记或冻 结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
扬州新瑞连投资合伙企业(有限合伙)	0	174,103,622	20.04	0	无	/	其他
香港中央结算有限公司	39,197,823	42,000,068	4.83	0	无	/	境外法人
汇成投资控股有限公司	0	37,716,667	4.34	0	无	/	境外法人
杨会	0	23,593,934	2.72	0	无	/	境内自然人
杨绍校	3,908,822	22,160,424	2.55	0	无	/	境外自然人
ADVANCE ALLIED LIMITED	0	20,000,000	2.30	0	无	/	境外法人
合肥新汇成微电子股份有限公司-2025年员工持股计划	18,990,900	18,990,900	2.19	0	无	/	其他
金燕	-104,976	15,504,391	1.78	0	无	/	境内自

							然人
宝信国际投资有限公司	0	12,500,000	1.44	0	无	/	境外法人
GREAT TITLE LIMITED	-1,100,000	11,896,933	1.37	0	无	/	境外法人
上述股东关联关系或一致行动的说明			①郑瑞俊、杨会为公司实际控制人，两人系夫妻关系。上述股东中，扬州新瑞连为杨会担任执行事务合伙人的企业，汇成投资为郑瑞俊控制的境外公司。上述股东中，扬州新瑞连、汇成投资、杨会构成一致行动人。 ②金燕系杨绍校兄弟的配偶。 除上述情形外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			不适用				

存托凭证持有人情况

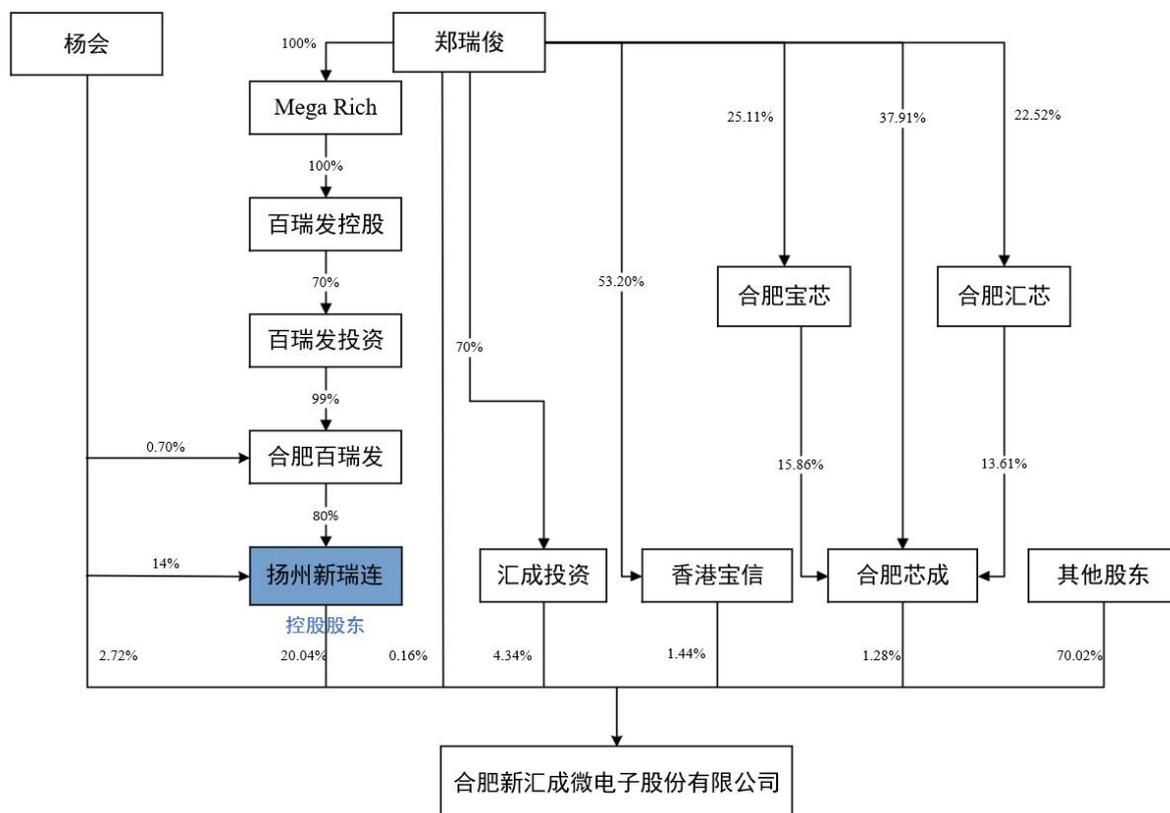
适用 不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

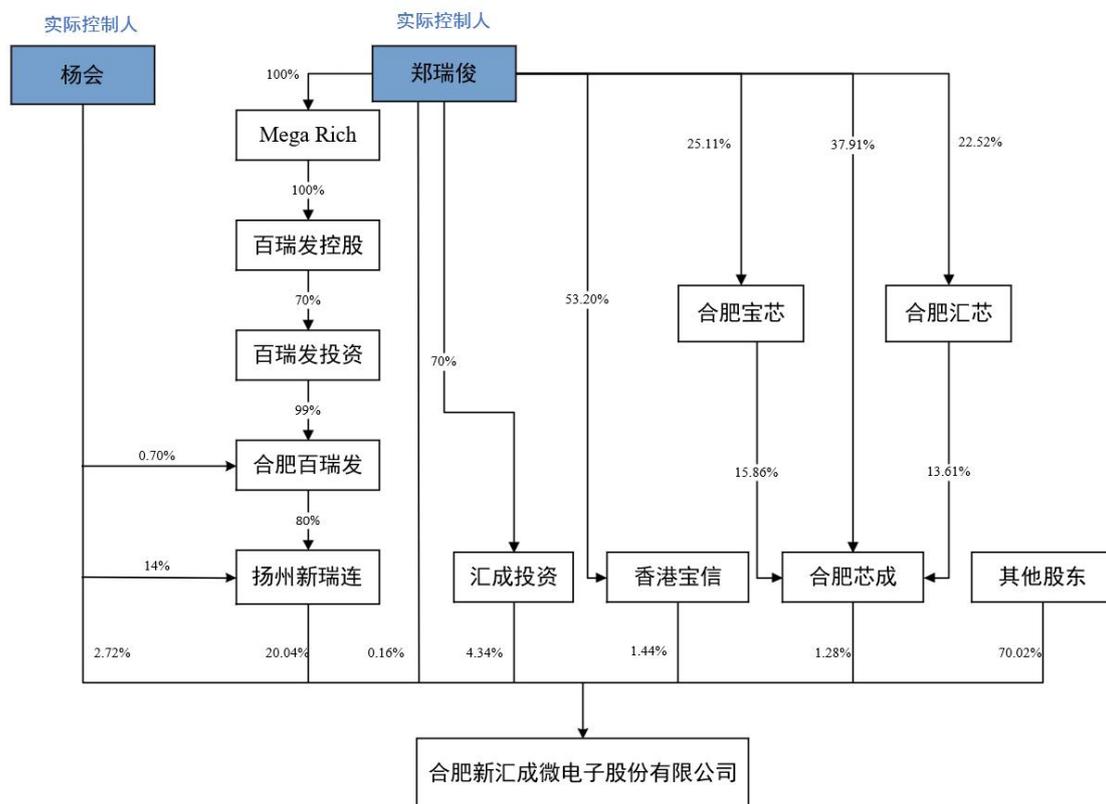
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5、公司债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业总收入 178,313.55 万元，较上年同期增长 18.79%；实现归属于上市公司股东的净利润 15,473.06 万元，较上年同期减少 3.15%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,409.96 万元，较上年同期减少 7.39%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用